

性能特点

- 高导热、低应力、低模量
- 不固化，可重工
- 可用于自动点胶
- 本身粘稠状，触变性好，不流淌，与接触器件粘合性好，接触热阻低、耐振动性好
- 优越的耐高低温、耐气候、耐老化及电绝缘性

产品描述

PAKCOOL® TG-570-KJ 系列可挤导热泥状态介于硅脂和橡皮泥状之间，易于涂抹和挤出或自动点胶，填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

该产品具有良好的触变性，胶料点胶时不滴落，涂抹时不任意流淌。进行缝隙填充时，使用厚度达到2mm时耐振动性仍然良好。

典型应用

- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 激光设备
- LED 照明
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

特性	TG-570-KJ	测试方法
外观	白色	--
粘度 (cP)	350 万±150 万	ASTM D2196-15
导热系数 (W/m·K)	7.0	ASTM D5470
密度 (g/cm³)	3.50±0.30	ASTM D792
挥发物 (% @150℃×3hrs)	≤0.80	GB 33372-2020
阻燃	V-0	UL 94
连续使用温度(℃)	-50~+150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 被涂器件材质如果吸油性很大，会使胶料状态有明显变厚变干的现象。故需表面处理为不吸油的器件，或用我司单组分胶表面涂抹以进行防吸油处理。器件材质不吸油的判断一般以常温涂上胶料 24 小时后状态无明显变化即可。
- 清洁涂覆件表面，取出足够量的本产品，通过挤出、涂抹或自动点胶填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触。每次用完应密封以备后用。

包装储运

- 本产品可提供 30mL、55mL 点胶针筒，330mL 胶瓶，1Kg、5Kg 和 20Kg 的桶装，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料，桶装产品室温下的储存期约 12 个月。如有在储藏期间有渗油出现，应将其搅拌均匀后使用；支装产品由于无法搅拌，应平放，储存条件：在<25℃环境下保存不超过 1 个月，在<0℃环境下保存不超过 6 个月；使用前应在 25℃条件下回温至少 4 小时，使胶料温度与使用环境温度一致后再使用。
- 可以作为一般液体化学品运输。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。